

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005年2月10日 (10.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/013346 A1

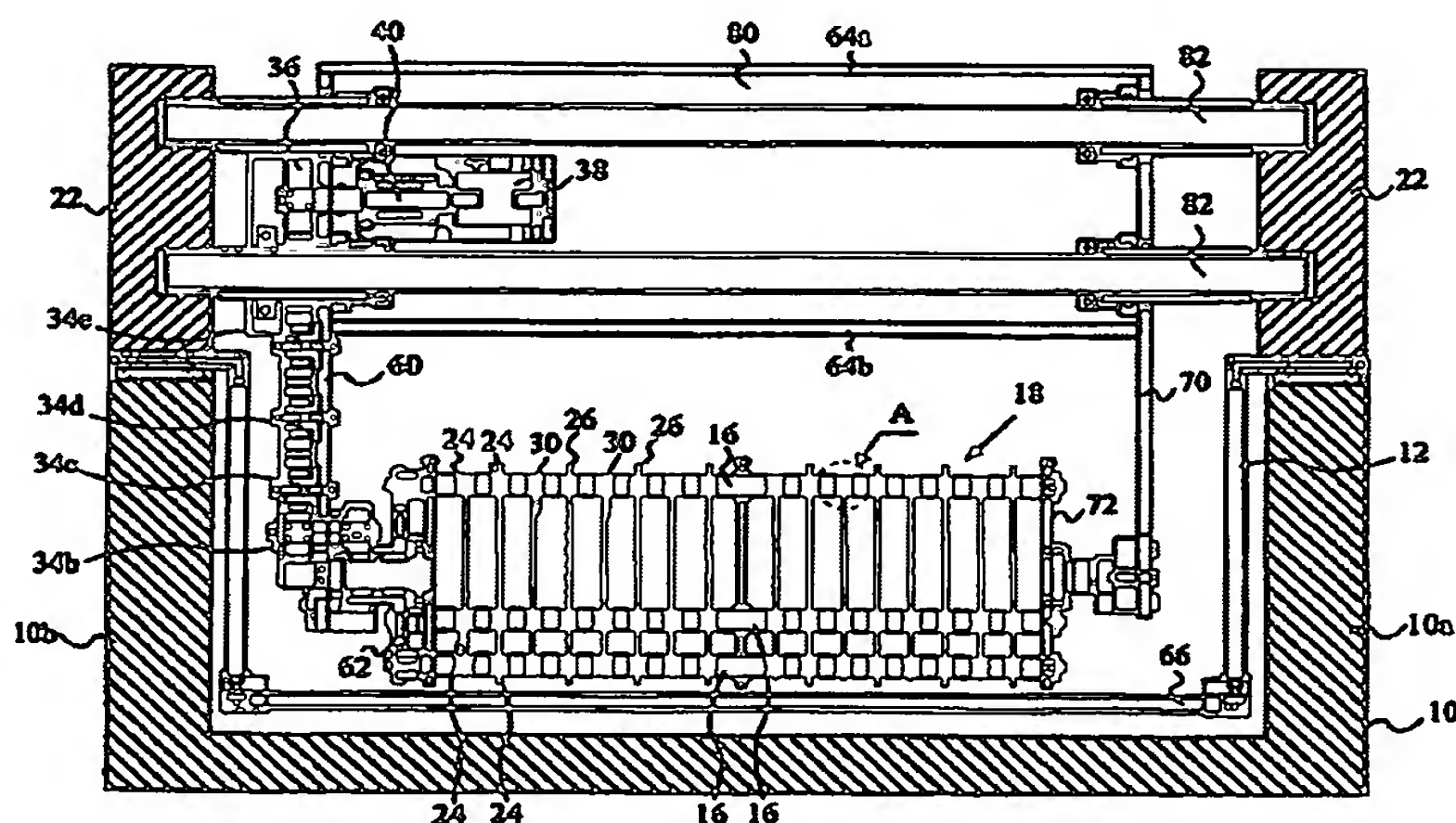
(31) 国際特許分類: H01L 21/306  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/010808  
(22) 国際出願日: 2004年7月29日 (29.07.2004)  
(25) 国際出願の言語: 日本語  
(26) 国際公開の言語: 日本語  
(30) 優先権データ:  
特願2003-204248 2003年7月31日 (31.07.2003) JP  
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): コマツ  
電子金属株式会社 (KOMATSU DENSHU KINZOKU  
KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平  
塚市四之宮3丁目25番1号 Kanagawa (JP).

(72) 発明者: および  
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 宮崎 正光  
(MIYAZAKI, Tadamitsu) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮3丁目25番1号 コマツ電子金属株式会社内 Kanagawa (JP). 平山 和也 (HIRAYAMA, Kazuya) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮3丁目25番1号 コマツ電子金属株式会社内 Kanagawa (JP). 相永 昌也 (FUKUNAGA, Hisaya) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮3丁目25番1号 コマツ電子金属株式会社内 Kanagawa (JP). 二村 公広 (FUTAMURA, Hiroyasu) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮3丁目25番1号 コマツ電子金属株式会社内 Kanagawa (JP).  
(74) 代理人: 木村 高久, 外 (KIMURA, Takahisa et al.); 〒1040043 東京都中央区浜1丁目8番11号 千代ビル6階 Tokyo (JP).

[図表有]

(54) Title: METHOD AND APPARATUS FOR ETCHING DISK-LIKE MEMBER

(54) 発明の名称: 円板状部材のエッチング方法及び装置



(57) Abstract: Disclosed are a method and apparatus for etching disk-like members, especially a method and apparatus for etching semiconductor wafers. In a method wherein wafers (30) are rotated and etched in an etching chamber (12) which is filled with an etching solution, a non-rotating cell plate (26) is disposed between two rotating wafers (30). In an etching apparatus wherein multiple wafers (30) are supported and rotated by a rod (16), a cell plate (26) is disposed between each two wafers (30). The cell plate (26) has a surface area roughly equivalent to that of the wafer (30).

(57) 要約: 本発明は、円板状の部材のエッチング方法及びエッチング装置に係り、特に、半導体ウェーハのエッチング方法及びエッチング装置に関する。エッチング液を満たしたエッチング槽(12)の内部で、ウェーハ(

[図表有]

WO 2005/013346 A1